

 산업통상자원부		보도자료		
http://www.motie.go.kr				
2020년 10월 30일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. (인터넷, 방송, 통신은 10월 29일(목) 오전 11시 이후 보도 가능)				
배포일시	2020. 10. 29.(목)	담당부서	반도체디스플레이과	
담당과장	조익노 과장(044-203-4270)	담당자	김대영 사무관(044-203-4272)	

삼성·에스케이하이닉스 연구기관 수장, 최초로 산업훈장 공동 수상

- 「제13회 반도체의 날」 기념식 개최, 역대 최대 규모인 51명 포상 -
 - 인공지능 반도체 초격차 창출 등 종합반도체 강국 도약 위한 민관 협력 다짐 -

- 산업통상자원부(장관 성윤모)는 '20.10.29일(목) 15시 서울 코엑스에서 정승일 산업통상자원부 차관, 진교영 한국반도체산업협회장(삼성전자 사장), 이석희 에스케이하이닉스 사장 등 반도체 분야 산·학·연 관계자 100여명이 참석한 가운데 「제13회 반도체의 날」 기념식을 개최하였음
- 「반도체의 날」은 우리나라 반도체 수출이 최초로 연 100억 달러를 돌파한 1994년 10월을 기념하여 제정된 이후, 2008년부터 매년 10월에 기념식을 개최해 왔으며,
- 13회를 맞은 올해 행사는 반도체 산업발전에 기여한 산·학·연 유공자에 대한 포상을 통해 그간의 노고를 격려하고, 메모리반도체 초격차 유지, 인공지능 반도체 신격차 창출 등을 통한 종합반도체 강국 도약을 위한 민·관의 긴밀한 협력을 다짐하는 자리로 그 의미가 깊음

< 행 사 개 요 >

- (일시/장소) 2020. 10. 29(목) 15:00~16:00 / 서울 코엑스 401호
- (참 석 자) 정승일 산업부 차관, 진교영 한국반도체산업협회장(삼성전자 사장), 이석희 에스케이하이닉스 사장 등 산업계 대표, 반도체산업발전 유공자 등 약 100여명
- (주요내용) 반도체 산업발전 유공자 포상(51점) 등

□ 정승일 차관은 축사를 통해 최근 코로나19로 세계경제가 어려운 가운데서도 수출·투자 등에서 우리경제의 든든한 버팀목 역할을 담당하고 있는 우리 반도체 업계의 끊임없는 노력에 감사의 뜻을 전하며, 급박한 대외환경 대응을 위해 민·관의 유기적인 협력이 다시 한 번 중요한 때임을 강조함

① 정 차관은 인공지능 반도체는 4차 산업혁명, 코로나 이후 시대의 반도체 시장을 바꿀 게임 체인저이자 시스템반도체 분야의 핵심 성장 동력으로,

○ 최근 관계부처 합동으로 마련된 ‘인공지능 반도체 산업 발전전략’을 통해 메모리반도체 초격차를 유지하는 한편, 인공지능 반도체 신격차를 창출하여 ‘종합반도체 강국’으로 도약하겠다는 포부를 밝힘

② 또한, 첨단산업의 세계적 집적화를 통한 소재부품장비 강국 도약을 위해 ①소재·부품·장비 개발·생산 역량 확충, ②첨단 산업 집중 유지 등 지난 7월 마련된 「소재·부품·장비 2.0 전략」을 차질없이 추진해 나갈 계획임을 언급함

③ 마지막으로 “최근 우리 반도체 산업을 둘러싼 대내외 환경은 어느 때보다 높은 불확실성으로 녹록지 않은 상황이지만, 모두가 합심해 변화와 혁신을 이루어낸다면 우리의 최종 목표인 ‘종합반도체 강국’이 꿈이 아닌 현실이 될 것이라 자신한다”고 강조함

□ 반도체의 날을 맞아 우리 반도체 산업 발전에 각고의 노력을 기울인 반도체 산업 유공자 51명에 대한 정부 포상도 진행함

* 정부 포상(총51점) : 은탑산업훈장(2), 산업포장(2), 대통령표창(3), 국무총리표창(4), 산업통상자원부 장관표창(40)

○ 금년 정부 포상규모 51명은 역대 최대 규모*로 국민경제에서 차지하는 반도체 산업의 중요성과 국제적 위상** 뿐만 아니라, 일본 수출규제에 대응해 소재부품장비 경쟁력 강화를 성공적으로 추진한 대표산업으로 상징성이 인정된 결과임

* 정부포상 규모 : ('18년) 47명 → ('19년) 49명 → ('20년) 51명

** 국가 전체 수출액 1위(19.2%, 19년), 국가 전체 설비투자 비중 1위(25.3%, 19년)
메모리반도체 세계 시장 점유율 1위(58.4%), 전세계 반도체 시장 점유율 2위(18.4%)

- 특히, 올해는 국내 반도체 산업의 양대축인 삼성전자와 에스케이하이닉스의 연구개발 기관 수장들이 역대 최초로 은탑산업훈장을 공동 수상하게 되어, 30년 이상 기술혁신에 매진해 온 현장 기술자에 대한 국가 차원의 예우로서 업계는 매우 환영하는 분위기임

○ 메모리 분야 미세화 한계 극복, 시스템반도체 핵심 기술을 개발에 기여한 삼성전자 강호규 부사장과 다수의 세계 최초 및 최고 수준 메모리 기술개발, 소부장 분야 상생협력에 기여한 에스케이하이닉스 김진국 부사장이 공동으로 은탑산업 훈장을 수상하였고,

* 강호규 부사장(삼성) : 6세대 브이(V)낸드 개발사업화, 업계 최초 14나노 모바일 프로세스 사업화 성공
김진국 부사장(SK) : 20나노급 8Gb LPDDR3 개발, 반도체 소부장 기술개발에 기여

- 산업포장은 솔브레인 박휴범 전무, 삼성전자 이경호 수석, 대통령 표창은 (주)라온텍 김보은 대표이사, (주)이오테크닉스 박종구 대표이사, 삼성에스디아이 박종호 전무, 국무총리표창은 광운대 권기청 교수, (주)티씨케이 박영순 대표이사, (주)에스앤에스텍 이종림 부사장, 디비하이텍 조기석 부사장이 수상하였음

* 박휴범 전무(솔브레인) : 12나인 수준의 고순도 불화수소 대량 생산능력 확보
이경호 수석(삼성) : 카메라 센서 분야 미세 픽셀 구조 및 자동 초점 특화 픽셀 개발

- 이외에도 산업통상자원부 장관표창 40명에 대해서도 시상하였음

< 반도체 산업발전 정부포상 대상자 >

구 분	훈 격	규모	비 고
정부 포상 (51점)	산업훈장(은탑)	2	강호규 부사장(삼성전자) / 김진국 부사장(에스케이하이닉스)
	산업포장	2	박휴범 전무(솔브레인) / 이경호 수석(삼성전자)
	대통령표창	3	김보은 대표이사(라온텍) / 박종구 대표이사(이오테크닉스) / 박종호 전무(삼성에스디아이)
	국무총리표창	4	권기청 교수(광운대) / 박영순 대표이사(티씨케이) / 이종림 부사장(에스앤에스텍) / 조기석 부사장(디비하이텍)
	장관표창	40	고현철 코미코 소장 외 39명

□ 한편, 정승일 산업부 차관, 진교영 한국반도체산업협회장 등 주요 참석자들은 기념식 행사 전 같은 장소인 코엑스에서 개최 중(10.27-30)인 국내 최대 반도체 종합전시회인 '반도체 대전 2020' 전시장을 방문하였음

* 99년부터 시작된 국내 최대 반도체 종합전시회(금년 216개사 487개 부스 규모)

○ 국내기업이 개발한 세계 최고 수준의 메모리, 소재·부품·장비, 인공지능 등 시스템반도체 설계기술 등이 전시된 10여개사 부스를 방문해 설명을 듣고, 관계자들을 격려함

- 【붙임】 1. 「제13회 반도체의 날」 기념식 개요
2. 「제13회 반도체의 날」 정부 포상자 명단
3. 반도체 대전 2020 주요 전시내용



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 반도체디스플레이과 김대영 사무관(☎ 044-203-4272)에게 연락주시기 바랍니다.

1. 추진배경

- ① 국가 주력산업인 반도체 산업의 성과와 위상을 대외에 홍보하고, 반도체 산·학·연의 노고를 격려하는 「반도체의 날*」 기념식 개최(10.29)

* '반도체 수출 100억불 달성('94.10.29)을 기념하여 10월 마지막주 목요일로 제정

- ② 기념식 행사장소인 코엑스에서 반도체 산업·기술 전망 관련 컨퍼런스, 주요 제품 전시 등을 포함한 「반도체 대전*」 개최(10.27-30)

* '99년부터 시작된 국내 최대 반도체 종합전시회(금년 150개社 480개 부스 규모)

2. 행사개요

- (일시/장소) '20.10.29(목) 15:00 ~ 16:00/ 코엑스 401호

* 반도체 대전 전시장(코엑스 3층 C홀) 방문은 14:15~14:50까지 진행

- (참석자) 산업부 차관, 진교영 협회장(삼성전자 사장), 삼성·SK하이닉스 등 수요기업, 팹리스, 소재·부품·장비기업 등 대표, 수상자 등 100여명

- (주요내용) ①반도체의 날 기념식(유공자 포상 등)

②반도체 대전 전시장 방문

3. 세부 일정(안)

	시간		내용	비고
(사전행사) 반도체 대전 관람 3층 Hall C	14:10~14:50	(40')	■ 반도체 대전 전시장 관람(13여개 부스)	3층 C홀
	14:50~15:00	(10')	■ 행사장 이동	3층→4층
(본행사) 반도체의 날 기념식 401호	15:00~15:05	(5')	■ 개회 및 국민의례	사회자
	15:05~15:10	(5')	■ 개회사	협회장
	15:10~15:15	(5')	■ 축사	산업부 차관
	15:15~16:00	(45')	■ 유공자 포상	산업부 차관

붙임 2

「제13회 반도체의 날」 정부 포상자 명단

□ 정부 포상 : 훈장(은탑2), 산업포장(2), 대통령표창(3),
국무총리표창(4), 산업부장관표창(40) 등 총 51점

포상 훈격	대상자	소속 및 직급	성명	공적 개요
산업 훈장 (은탑)		삼성전자(주) 부사장	강호규	- 세계 최초 Air Gap 공정 적용 D램 제품 양산 등 미세화 한계 및 난제 극복을 통한 경쟁사비 기술력 확보 - 고집적/고성능 모바일 프로세스용 시스템반도체 제품 경쟁력 확보를 위한 핵심 기술 개발
		SK하이닉스(주) 부사장	김진국	- 세계 최초/최고 수준의 메모리 기술/제품 개발을 통해 글로벌 선두업체로 도약의 발판 마련에 기여 - 산학 협력 강화를 통한 '선순환 개방형 혁신' 연구 생태계 활성화에 기여
산업 포장 (2점)		솔브레인(주) 전무	박휴범	- 세계 최고 수준의 고순도 불화수소(12N)를 대량생산 할 수 있는 능력 확보에 크게 기여 - 최초의 독자기술로 CMP 슬러리 개발에 성공
		삼성전자(주) 수석	이경호	- 카메라 센서 분야 최고 수준 픽셀 독자 기술 개발 - 멀티카메라 확대, 차량용 등 센서 신기술 개발/사업화를 통한 시장 개척에 기여
대통령 표창 (3점)		(주)라온텍 대표이사	김보은	- 세계 최초/유일 어지러움증 없는 AR 기술, 광학 보정 기능 SoC 기술 개발 - 세계 최소 크기/최저 전력 FHD/QHD 해상도 기술 확보에 기여
		(주)이오테크닉스 대표이사	박종구	- 세계 최초 Wafer Annealing 장비 개발 및 양산화 성공 등 반도체 전공정의 경쟁력 강화에 기여 - 반도체 핵심 부품인 Laser Source 및 Laser Diode 포함 90% 이상 국산화 달성
		삼성SDI(주) 전무	박종호	- 반도체 핵심 소재의 美/日 의존도에서 탈피, 국내 기반 기술 확보 및 국산화율 제고 2, 3차 중소협력회사와 대기업 間 공정거래 및 동반 성장 실천
국무 총리 표창 (4점)		광운대학교 교수	권기청	- 반도체 기술로드맵 수립 기획 등에 참여하여 기술 발전에 기여 - 중소기업과의 과제를 통해 중소기업의 성장 및 신제품 개발에 기여
		(주)티씨케이 대표이사	박영순	- 국내외 반도체 장비업체 부품 공급 및 세라믹코팅 기술력을 세계적인 수준으로 향상에 기여 - 기술적 격차를 확대함으로써 고용창출은 물론 수출 증대에 기여
		(주)에스앤에스텍 부사장	이종림	- 일본 수입에 의존하던 포토마스크 핵심 재료 블랭크 마스크 최초 개발로 생산성 증대에 기여 - 국내 반도체 시장의 신뢰 구축과 산업 경쟁력 강화에 기여
		(주)DB하이텍 부사장	조기석	- Specialy CIS 공정 확보 등 Foundry 공정 경쟁력 강화 등 시스템 반도체 시장 확대 - 국내 팹리스 업체들과의 상생협력을 통해 산업 성장에 기여

포상훈격	소 속	직급	성명	공적 개요
산업부 장관표창 (20/30)	(주)DB하이텍	수석	고광영	■ 전력반도체 고부가가치 BCD 공정기술을 전압 및 application 용도에 따라 세계적 수준으로 개발
	(주)코미코	소장	고현철	■ 전량 해외에 의존하던 세라믹 코팅용 소재를 국산화 개발하여 고객의 원가 경쟁력 향상에 기여
	한미반도체(주)	이사대우	김남현	■ 반도체 장비의 제어시스템을 개발하는 직무를 담당하여 국내 반도체 장비 산업의 성장 주도
	(주)지니틱스	수석	김동원	■ 자동초점 구동기, 손떨림보정 SoC 등을 개발하여, 국내 시스템반도체산업의 발전에 기여
	버숨머트리얼즈코리아(주)	전무	김무성	■ 실리콘 반도체용 박막의 재료 및 공정에 이르기까지 이 분야 기술 및 산업 발전에 기여
	(주)월비에스엔티	부사장	김민규	■ 대부분 수입에 의존하였던 반도체 장비의 소모성 부품 리테이너링의 국산화 성공에 기여
	(주)에스아이	대표이사	김종훈	■ 해외 선진사 제품 기술적 분석을 통해 응용기술을 개발 및 장비 국산화를 통한 수출에 기여
	(주)에프에스티	부사장	김지강	■ 고품질의 펄리클을 국산화 개발하였으며, 양산 공급을 통해 국내 반도체 산업 발전에 기여
	(주)메카로	상무	김형민	■ 반도체 CVD공정용 Metal Heater block 국내 최초 국산화 개발 및 양산 적용에 기여
	세메스(주)	상무	남신우	■ 지속적인 제품개발(Etch)과 양산 안정화(전체설비)로 국내 반도체산업 발전에 유무형적으로 기여
	(주)원익아이피에스	부장	박영훈	■ 외국 장비를 대체할 수 있는 NOA ALD-TiN JEP를 개발, 국산 장비의 경쟁력 향상에 기여
	(주)엑시콘	수석	신종경	■ 시장 경쟁력을 갖춘 국산 시스템 반도체 설비 개발과 반도체 검사 장비의 국산화 개발에 기여
	엠케이피(주)	부사장	양달승	■ 국산화 및 상생협력 3대 사업의 위원활동을 통한 국내 장비 및 부품 기업들의 성장에 기여함
	피에스케이홀딩스(주)	그룹장	엄상희	■ 반도체 메모리 산업에서의 제품 수출향상 및 양산공정 안정화를 통해 장비 경쟁력 향상에 기여
	하이엔드테크놀로지(주)	대표이사	오찬권	■ 세계 최초 1G SDRAM 개발 연구원으로 참여하였으며, 소재/부품/장비 인력양성 기여
	(주)넥스틴	이사	왕희준	■ 국내 유일 반도체 전공정 나노미터급 패턴결함 광학검사 장비를 공급하여 수입 대체의 기여
	(주)에스티아이	상무	우영수	■ 반도체 dry etch 설비 주요 파트의 최초 국산화로 부품 산업 기술 경쟁력 확보에 기여
	(주)옵토레인	팀장	원준호	■ CMOS photosensor를 기반으로 한 바이오 융합 반도체 센서를 개발하여 양산화에 기여
	삼성전자(주)	PE	이병준	■ 고성능 메모리 제조에 적합한 핵심 설비들을 개발하여 세계 최초 HBM 양산이 가능하도록 기여함
	피에스케이(주)	수석	이윤영	■ 반도체 신규 공정 개발 및 안정화, New Platform 개발을 통한 다양한 제품 시장 진입을 가능하게 함

포상훈격	소 속	직급	성명	공적 개요
산업부 장관표창 (10/30)	(주)시노펙스	팀장	이하나	▪ 다수의 외산 FILTER 대체 CMP용 POU FILTER 및 CARTRIDGE FILTER의 국산화 개발 완료에 기여
	(주)진성이엔지	대표이사	장준재	▪ 반도체 제조공정에 필요한 핵심부품인 특수 GAS 배관, 케미컬배관 등 제품효율 향상에 노력
	삼성전자(주)	그룹장	전봉길	▪ 시스템 반도체 제조를 위한 미세공정의 핵심 기술인 Foundry형 EUV 양산 기술력을 확보하는데 기여
	SK하이닉스(주)	PL	정진중	▪ 반도체 제품 공정기술의 양산 적용 및 안정화로 수율 및 품질 개선을 주도적으로 진행
	한국표준과학연구원	팀장	제갈원	▪ 반도체 제작 공정에서 활용되는 광측정장비의 정확도, 정밀도 평가를 위한 박막두께 표준물질 개발에 기여
	SK하이닉스(주)	TL	조종호	▪ 세계 최초 CoC PKG 양산을 통한 신규 Biz 매출 창출 및 자사 독자 기술 개발/내재화를 통한 품질 혁신에 기여
	(주)미코세라믹스	팀장	채제호	▪ 반도체 증착 장비에 사용되는 핵심 부품인 세라믹 히터의 국산화를 통해 국내 세라믹 산업 발전에 기여
	엠코테크놀로지코리아(주)	수석	최민수	▪ TEST 공정의 자동화 개선을 통한 생산성 향상에 기여, 장비 개발로 원가절감 및 장비 국산화에 기여
	(주)실리콘마이터스	이사	최재순	▪ PMIC 개발 및 양산을 통한 기술 및 신뢰성 축적으로 Automotive 전력 반도체 개발의 기반 마련
	충북대학교	교수	최호용	▪ 학부 및 대학원의 반도체 교육체계 구축 및 고용연계 산업체 트랙을 운영하여 반도체 산업 인력 양성에 기여
산업부 장관표창 (대중소 상생협력) (10/10)	(주)테스	연구위원	김광수	▪ 다양한 부분품 업체와 협력을 진행하였으며, 성공적으로 평가가 완료된 부분품의 국산화 및 양산 적용에 기여
	(주)DB하이텍	수석	김덕중	▪ 성능평가사업이 성공적으로 진행되도록 적극 지원, 반도체소재 관련 국내업체 발굴에 기여
	SK하이닉스(주)	TL	문지원	▪ 성능평가사업을 주도적으로 수행하였으며, 외산독점 소재를 국산화로 대체하여 국내 반도체 경쟁력에 기여
	무진전자(주)	이사	박형수	▪ 국내 최초 매엽실 세정장비를 개발하여 국내 세정 장비 시장 확대 및 국내 부품사 발굴 및 협업에 노력
	(주)유진테크	과장	성세종	▪ 디램, 낸드게이트 질화막 공정개발과 관련하여 국내 반도체 장비 및 부품업체와 공동개발을 진행
	삼성전자(주)	수석	손영훈	▪ 성능평가사업을 활용한 Wafer 평탄도 측정 원천기술 국산화를 지원, 성능평가 사업 전문위원으로 참여
	주성엔지니어링(주)	수석	손 청	▪ 2차 협력사와 TSD 시스템 모듈화 및 하드웨어 최적화 작업을 통해 양산평가 기회 제공 등에 기여
	(주)원익아이피에스	과장	송태정	▪ 수출 제한에 관한 법률적 리스크 검토 및 장비/부품/소재 국산화와 관련하여 계약 등을 주관함
	와이아이케이(주)	상무	송호성	▪ 반도체 테스터의 부품 국산화 및 기능 사항 업그레이드를 통해 성능 향상에 기여
	피에스케이(주)	책임	한송이	▪ 핵심 부품의 국산화율을 높여 경쟁력 확보, Bevel Etch 장비 개발에 참여하여 장비 경쟁력 강화에 기여

분야	참가기업	전시 제품 내용
메모리	● 글로벌 Top 경쟁력을 유지하고 있는 메모리 제품 출품	
	삼성전자	고부가가치 소비자용 SSD(980 pro), 5G 통합 시스템온칩 엑시노스 980, 업계 최대 화소수를 자랑하는 아이소셀, EUV공정 적용 3세대 10나노급 D램
	SK하이닉스	세계 최초 10nm급 DDR5 제품, 3D 기술을 구현한 D램의 차세대 제품 HBM, 4D 낸드플래시
소부장	● 정부의 소부장 육성사업과 함께 경쟁력을 한껏 끌어올리고 있는 국내 소부장 기업 제품·기술 출시	
 	원익IPS	3D NAND용 증착 ALD장비, PECVD 장비
	엑시콘	SSD 테스터에 최적화된 초고속/고신뢰성 테스터
	PSK	PR 드라이스트립(DryStrip) 장비 세계 1위
	동진세미캠	국내 소자기업에 납품을 시작한 ArF용 PR
	프리시스	반도체 장비용 고진공 밸브를 최초로 국산화
시스템반도체	● 국내 시스템반도체 발전을 위한 파운드리/IP 기술 소개	
	ADT	TSMC 7나노 반도체 제조 공정기술 소개
	칩스앤미디어	자율차용 딥러닝 기반 솔루션과 AI 설계기술
	Si Five	SoC Turn-Key 서비스 및 디자인 플랫폼
정부사업홍보관	● 국내 반도체기업 정부지원사업 홍보관	
	파워반도체 상용화개발사업	국내 파워반도체상용화사업 참여기업·기관의 R&D 성과 대외 홍보, 사업화 지원 및 관련분야 인력양성 현황 공유
	글로벌수요연계형 R&D사업	국내 시스템반도체기업의 글로벌시장 진출지원을 위한 R&BD 플랫폼 사업 소개
기술세미나	● 반도체 시장동향세미나 및 반도체 산학연 교류 워크샵	
	시장세미나	주요 증권사 애널리스트들이 연사로 참여하여 글로벌 IT시장 및 국내외 반도체 산업 환경 전망
	반도체 산학연워크샵	반도체 산업계, 학계, 연구기관 정부 교류의 장